

자람테크놀로지, 공모가 22,000원 확정

- ▶ 국내외 1,774개 기관 참여...경쟁률 1,702대 1 기록
- ▶ 이달 22일~23일 청약 거쳐 오는 3월 7일 코스닥시장 상장예정

<2023-02-20>차세대 시스템 반도체 전문기업 자람테크놀로지(대표이사 백준현)가 지난 15~16일 양일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 밴드(16,000원~20,000원)의 상단을 초과한 22,000원으로 확정했다고 20일 밝혔다.

이번 수요예측에는 국내외 1,774개 기관이 참여해 1,702대 1의 경쟁률을 기록했다. 자람테크놀로지의 공모가가 확정됨에 따라 총 공모금액은 205억 원으로 결정되었다.

상장을 주관한 신영증권 관계자는 “자람테크놀로지의 우수한 시스템 반도체 설계능력과 핵심제품인 XGSPON SoC와 XGSPON 스틱 제품의 높은 성장성 등을 투자자분들께서 높이 평가해주셨다”며 “아울러 어려운 시장상황을 고려해 구주매출을 없애고 100% 신주발행으로 진행한 점, 실제 유통가능 물량이 상장예정주식수 중 14.14%밖에 되지 않는 점 등 최대한 시장친화적으로 구성한 공모 구조도 투자매력도를 높였을 것”이라고 밝혔다.

자람테크놀로지는 2000년 1월에 설립된 시스템 반도체 설계 전문기업이다. PABX교환기용 칩, 오디오 신호처리 칩, 음성인식 칩, 하이패스 단말기용 반도체 등 다양한 반도체의 개발과정서 축적한 기술력과 노하우를 보유하고 있다. 핵심 제품은 ▲효율적인 5G기지국 설치를 가능케하는 5G용 시스템 반도체 XGSPON SoC (국내 최초 개발 및 상용화) ▲XGSPON SoC를 광트랜시버에 부착한 스틱 형태의 제품인 XGSPON STICK (세계 최초 상용화)이 있다.

자람테크놀로지의 XGSPON 스틱제품은 팬데믹 이후 급격하게 성장하는 글로벌 초고속 인터넷 시장과 5G 스몰셀 연결에 사용되는 핵심부품으로, 글로벌 29개 고객사에 3천개 이상의 샘플을 공급했으며, 장비 호환성 시험과 시범서비스를 진행중인 고객들이 많아 본격적인 성장을 앞두고 있다.

자람테크놀로지는 경쟁사와의 차별화 및 경쟁우위 확보를 위해 차세대 제품 개발에 힘쓰고 있다. 특히 25GS-PON SoC를 2023년 하반기에 세계 최초로 출시하려는 목표로 개발에 박차를 가하고 있다. 25GS-PON SoC를 시장에 출시했거나 제품 개발 로드맵에 올린 경쟁사는 현재 없는 상태다. 개발이 예정대로 진행되면 자람테크놀로지는 글로벌 시장을 선점할 수 있고, 시장의 기술 트렌드를 이끌 것으로 기대된다.

자람테크놀로지는 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금 대부분을 연구개발과 시설투자에 사용해 핵심 연구인력에 대해 최적의 연구개발 환경을 제공할 계획이다.



자람테크놀로지 백준현 대표는 "자람테크놀로지의 앞선 기술력과 미래 성장성에 믿음을 주신 투자자 여러분께 깊은 감사의 마음을 전한다"며 "IPO 일정이 지연되긴 했지만 상장 추진에 대한 약속을 지킬 수 있어 기쁘게 생각한다"고 소감을 밝혔다.

이어서 백준현 대표는 "이번 상장을 계기로 삼아 대한민국 반도체 산업의 발전에 기여함은 물론 시장선도자의 위치에 올라서는 글로벌 시스템 반도체 리딩기업이 되겠다"며 포부를 전했다.

한편 자람테크놀로지는 이달 22일~23일 일반투자자 청약을 거쳐 오는 3월 7일 코스닥시장에 상장 예정이다. 주관사는 신영증권이다.

-끝-